فر آیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۱۲، شماره ۲، تابستان ۹۷

بررسی رفتار خوردگی پوشش تانتالم لایهنشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی

مصطفی علیشاهی¹*، فرزاد محبوبی^۲، سید محمد موسوی خوئی^۳ ۱- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲- استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران ۲- دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران ۲- عهده دار مکاتبات: m.alishahi@hsu.ac.ir

چکیده: در این پژوهش پوشش تانتالم به روش کندوپاش مگنترونی جریان مستقیم روی سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگنزن ۱۹۱۲ لایه نشانی شد. خواص ساختاری پوشش تانتالم به کمک آزمون پراش پر تو ایکس ارزیابی شده و از میکروسکوپهای الکترونی عبوری و روبشی و همچنین میکروسکوپ نیروی اتمی جهت بررسی سطح مقطع و مورفولوژی سطح پوشش استفاده شد. افزون بر این، رفتار خوردگی پوشش تانتالم در مقایسه با فولاد زنگنزن ۱۹۲۲ به کمک آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بررسی شده و از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی جهت تعیین مکانیزمهای خوردگی استفاده شد. نتایج نشان دادند که استفاده از لایه آستری نیترید تانتالم، می تواند سبب تغییر ساختار کریستالی پوشش تانتالم از مخلوط فازی α و β به ساختار تک فاز ۵، و کاهش مقاومت الکتریکی پوشش از حدود ۹۰ به ۱۵ میکرواهم در سانتی متر شود. همچنین مطالعات میکروسکوپی نشان دادند که پوشش تانتالم ساختاری ستونی و بسیار فشرده با سطحی یکنواخت و بدون عیب از خود نشان داده و زبری میانگین آن خورنده با زیرلایه جلوگیری کرده و بازده حفاظت بیشتر از ۹۰ درصد را سب می شود. در این ارتباط، نفوذ محلول خورنده به زیرلایه از طریق حفرات راهباز موجود در پوشش به عنوان مکانیزم خوردگی پوشش تانتالم مانند یک سد فیزیکی از تماس محلول خورنده با زیرلایه جلوگیری کرده و بازده حفاظت بیشتر از ۹۰ درصد را سب می شود. در این ارتباط، نفوذ محلول خورنده به

> **واژدهای کلیدی:** پوشش تانتالم، کندوپاش مگنترونی، خوردگی، پلاریزاسیون، طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی، حفرات راهباز.

> > ۱- مقدمه

خوردگی، مقاوم سایش، روانکار، تزیینی و یا پوششهایی با خواص خاص الکتریکی و یا نوری داشته است [۱۰–۴]. کندوپاش مگنترونی، روشی مقرون به صرفه است که می تواند پوششهای لایه نازک را با خلوصی بالا و چسبندگی عالی روی سطحهای بزرگ لایهنشانی کند [۴، ۱۱]. پوشش دهی سطح یکی از بهترین و اقتصادی ترین روش ها جهت افزایش مقاومت خوردگی سازه های فلزی در برابر محیط های خورنده است [۳–۱]. روش کندوپاش مگنترونی یکی از روش های لایهنشانی فیزیکی بخار (PVD)^۲ است که در دهه گذشته توسعه زیادی جهت تولید پوشش های سخت، مقاوم

تانتالم یکی از فلزات دیرگداز با دمای ذوب ۲۹۹۶ درجه سانتی گراد است که خواص ماشین کاری عالی و دمای انتقال تردی-نرمی بسیار پایین دارد [۱۲]. تانتالم دو ساختار کریستالی مشخص دارد. فاز پایدار α که ساختار obc دارد و فاز نیمه پایدار β که ساختار کریستالو گرافی آن تتراگونال است. تانتالم α خواص شیمیایی، حرارتی و مکانیکی خوبی نظیر مدول الاستیک بالا درحد فولاد، نقطه ذوب بالا، فرم پذیری و داکتیلیتی خوب، مقاومت الکتریکی کم و همچنین مقاومت شیمیایی عالی در برابر اسیدها و گازهای خورنده دارد، در حالیکه ساختار β ، فازی ترد و شکننده با مقاومت الکتریکی بالا است که در دمای بالاتر از ۱۰۳۳ درجه کلوین به فاز α تبدیل می شود [۱۳].

لایهنشانی کندوپاش مگنترونی یکی از روش های متداول برای لایهنشانی پوشش تانتالم و ترکیبات آن است [10–١٣]. در این ارتباط، بسته به نوع زیرلایه و شرایط لایهنشانی، ساختار پوشش تانتالم می تواند فاز ۵، β و یا مخلوطی از هر دو باشد [19]. با کنترل شرایط لایهنشانی تانتالم، بسته به کاربرد مورد نظر می توان پوشش هایی با مقاومت الکتریکی کم و یا زیاد، مقاومت سایشی و خوردگی مناسب، دمای ذوب بالا و شکل پذیری خوب تولید کرد [17]. پوشش های تانتالم می توانند در صنایع الکترونیک [17]، نظامی [10–۲۰] شیمیایی [11] و پزشکی [۲۲–۲۳] کاربرد داشته باشند.

مقاومت خوردگی بالای آلیاژهای پایه تانتالم عموماً به تشکیل یک لایه رویین نازک، نفوذناپذیر و خنثی (احتمالاً پنتوکسید تانتالم^۳، 20₂(Ta₂O₅) روی سطح آنها نسبت داده می شود. این لایه رویین بسیار نازک و بدون عیب بوده که پیوندی قوی با تانتالم برقرار کرده و در صورت صدمه دیدن می تواند خود را ترمیم کند [۲۴–۲۵]. با وجود اینکه مقاومت خوردگی تانتالم و ترکیبات آن در اکثر محیطهای شیمیایی عالی است [۲۶–۲۴] و انتظار می رود که پوشش های پایه تانتالم گزینه مناسبی برای حفاظت از سازههای فلزی در برابر خوردگی باشند، تاکنون تحقیقات کمی در ار تباط با رفتار خوردگی این پوشش ها صورت پذیرفته است [۲۰–۲۲].

در این پژوهش پوشش تانتالم به روش کندوپاش مگنترونی جریان مستقیم به طور همزمان روی زیرلایه سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگنزن ۲۱۶L لایهنشانی شد. پوشش حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)^۵، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)⁹ و روش پراش پرتو ایکس (XRD)^۷ ارزیابی شد. همچنین رفتار خوردگی پوشش تانتالم در مقایسه با فولاد زنگنزن ۲۱۶L به کمک آزمونهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک (PDP)^۸ و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)^۹ ارزیابی شده و بازده حفاظت پوشش محاسبه شد.

۲- مواد و روش انجام تحقيق

در این پژوهش از سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگنزن ۳۱۶L به عنوان زیرلایه استفاده شد. پیش از لایهنشانی، زیرلایه های فولادی با استفاده از کاغذ سنباده کاربید سیلیسیم تا درجه ۴۰۰۰ میکرومتر خورده و سپس توسط پودر الماس، تا درجه ۰/۰۵ میکرومتر پولیش شد. هر دو نوع زیرلایه پیش از قرار گرفتن درون محفظه لایهنشانی، ابتدا به مدت ۱۰ دقیقه در استون و سپس ۱۰ دقیقه در اتانول تمیزکاری آلتراسونیک شده و در نهایت توسط گاز نیتروژن خشک شدند.

لایه نشانی پوشش تانتالم به روش کندو پاش مگنترونی جریان مستقیم از یک تارگت ۳ اینچی دایره ای شکل از جنس تانتالم (خلوص ۹۹/۹۵ درصد) انجام شد. در سیستم مورد استفاده تارگت تانتالم در فاصله ۱۵۰ میلی متری و در روبروی زیرلایه های متصل به زمین ۱۰ قرار گرفت. فشار پایه در محفظه لایه نشانی حدود ۲۰۰ میلی بار بود و لایه نشانی پوشش تانتالم در فشار کاری حدود ۳۰۱۰ × ۲/۵ میلی بار با شار ۲۵ سانتی متر مکعب بر دقیقه (sccm) گاز آرگون (خلوص ۹۹/۹۹) انجام شد. در زمان لایه نشانی، دمای زیرلایه توسط یک سیستم آب گرد در حدود ۲۰ درجه سانتی گراد ثابت نگه داشته شد. لایه نشانی پوشش تانتالم بدون اعمال بایاس به زیرلایه و به مدت ۱۲۰ دقیقه انجام شد.

(®) Dektak-150 (Veeco) اندازه گیری شد. مطالعات میکروسکوپی بر روی نمونهها توسط FESEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)^{۱۱} و AFM صورت پذیرفت و از XRD جهت بررسی ساختار کریستالی و محاسبه اندازه دانه پوشش استفاده شد. مقاومت الكتريكي پوشش،ها توسط آزمون چهار يين^{١٣} اندازه گيري شد. رفتار خورد گي فولاد زنگنزن ۳۱۶L و پوشش تانتالم در محلول 0.5 M H₂SO₄ + 2 ppm HF در دمای محیط توسط آزمونهای PDP و EIS ارزیابی شدند. این محلول به طور رایج جهت شبیهسازی محیط کاری پیل های سوختی با غشای تبادل پروتون استفاده می شود [10]. در سلول الكتروشيميايي مورد استفاده، نمونه الكترود كاري بوده و از يك توري يلاتيني به عنوان الكترود كمكي و يك الكترود استاندارد کالومل (SCE) به عنوان الکترود مرجع استفاده شد.

٣- نتايج و بحث ۳-۱- مشخصه یابی یوشش تانتالم

شكل (۱-الف) الكوى XRD پوشش تانتالم لايەنشاني شده روى سيليكون را نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه بدون استفاده از لايه آستری نیترید تانتالم، ساختار کریستالی پوشش تانتالم مخلوطی از فازهاي α و β است. افزون بر اين، مقاومت الكتريكي اين پوشش حدود ۹۰ میکرواهم در سانتیمتر اندازه گیری شد، که این مقدار بیشتر از مقاومت فاز α بوده و در تایید آزمون XRD بیان گر حضور فاز β در پوشش است. نتایج نشان دادند که استفاده از لایه آستری نيتريد تانتالم به ضخامت حدود ٥٠ نانومتر، سبب كاهش مقاومت الکتریکی پوشش تانتالم به حدود ۱۵ میکرواهم در سانتیمتر شد. بررسی الگوی XRD این پوشش (شکل (۱-الف)) نشان داد که اثري از حضور فاز β در پوشش وجود ندارد و ساختار کريستالي تانتالم a در پوشش مشاهده می شود. ایکدا^{۱۵} و همکاران [۳۱] نشان دادند که صفحه کریستالی (۱۱۱) تانتالم α می تواند به صورت شبه اپی تکسیال^{۱۶} روی صفحه (۱۱۱) فاز نیترید تانتالم مکعبی(c-TaN) رشد کند. شایان ذکر است بررسیها نشان داد که ساختار كريستالى پوشش تانتالم لايەنشانى شدە روى زيرلايە فولاد

سيليكون است. (الف) Vormalized intensity (a.u.)

with TaN

seed layer

without TaN eed laver

زنگنزن ۳۱۶L نیز مشابه با یوشش لایهنشانی شده روی زیرلایه



شکل (۱): (الف): اثر لایه آستری TaN بر الگوی XRD پوشش تانتالم و (ب): تصویر TEM از مقطع عرضی پوشش تانتالم و لایه آستری TaN روی زير لايه سيليكون

شكل (۱-ب) تصوير TEM از فصل مشترك زيرلايه سيليكون، لايه آستري نيتريد تانتالم و پوشش تانتالم را نشان ميدهد. مشاهده می شود که لایه آستری نیترید تانتالم با ضخامت حدود ۵۰ نانومتر ساختار و دانهبندی مشخصی ندارد، در حالیکه پوشش تانتالم α ساختاري ستونى داشته كه هر ستون حاوى دانه هاى مجزا با اندازه حدود ۴۰ نانومتر است. ساختار ستونی پوشش تانتالم بسیار فشرده بوده و اثري از حفرات بين ستوني و يا ساير عيوب در آن مشاهده نمی شود. همچنین فصل مشتر کها پیوسته بوده و از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. هیچ اثری از عدم اتصال و عیوب در فصل مشترک مشاهده نشده و ارتباط خوبی بین پوشش تانتالم و لایه

آستری نیترید تانتالم برقرار است. این ساختار بدون عیب و فشرده در بررسی خواص خوردگی بسیار حائز اهمیت است [۱۵]. با استفاده از رابطه شرر^{۷۷} [۳۲] و تعیین عرض در نیمه ارتفاع پیک (۱۱۰) در الگوی XRD، اندازه دانه پوشش تانتالم حدود ۲۰ نانومتر محاسبه شد. اختلاف بین اندازه دانه محاسبه شده توسط رابطه شرر و مقدار اندازه گیری شده در تصویر MET (حدود ۴۰ نانومتر) ناشی از این واقعیت است که رابطه شرر اندازه کریستالیت ها را محاسبه می کند ولی در تصویر MET، دانه بندی پوشش مشاهده می شود. هر دانه مشاهده شده در تصویر TEM می تواند از چندین دانه فرعی یا کریستالیت تشکیل شده باشد. مقایسه موقعیت پیکهای الگوی XRD پوشش تانتالم با نمونه مرجع بیان گر جابه جایی پیکهای پوشش تانتالم به سمت راویه های پراش کو چکتر است. این جابه جایی در موقعیت پیکها را می توان به حضور تنش فشاری در پوشش نسبت داد [۳۲]. در

این ارتباط، تنش فشاری موجود در پوشش با اندازه گیری انحنای زیرلایه سیلیکونی پیش و پس از لایهنشانی و به کمک رابطه استونی^{۱۸}، اندازه گیری شد [۳۴–۳۳]:

$$\sigma = \frac{E_{s}h_{s}^{2}}{6rh_{f}(1-v)}$$
(1)

در این رابطه Es و ۷ به ترتیب مدول الاستیک و ضریب پواسون زیرلایه هستند، که این مقادیر برای سیلیکون (۱۰۰) به ترتیب برابر با ۱۳۰ گیگاپاسکال و حدود ۲۵/۵ است. h_f و h_f به ترتیب ضخامت زیرلایه و پوشش هستند که مقادیر آنها به ترتیب حدود به ۲۰۰ میکرومتر و ۹۶۰ نانومتر است. تفاوت شعاع انحنای زیرلایه پیش و پس از لایهنشانی را نشان می دهد که توسط پروفیلومتر حدود ۲/۴ متر اندازه گیری شد. با انجام محاسبات، مقدار تنش پسماند پوشش تانتالم، حدود ۱/۴ گیگاپاسکال اندازه گیری شد. استفاده است که توسط مکانیزم کوبش اتمی^{۱۱} شرح داده می شود [۳۵–۳۷]. در این مکانیزم، وجود تنش فشاری در پوششهای حاصل از کندوپاش در فشار پایین، به دلیل مسیر میانگین آزاد

طولانی موجود در محفظه لایهنشانی، به بمباران پوشش در حال رشد توسط ذرات پرانرژی نسبت داده می شود. بمباران سطح در حال رشد پوشش توسط ذرات پرانرژی سبب تولید عیوب نقطهای در پوشش و اعوجاج شبکه شده [۳۸–۳۷] و همچنین فشرده شدن ریزساختار [۴۰–۳۹] را به همراه دارد، که هر دو عامل می توانند تنش فشاری بوجود آورند.

شکل (۲-الف) تصویر FESEM از سطح پوشش تانتالم را نشان میدهد. مورفولوژی سوزنی شکل در سطح این پوشش به خوبی مشاهده میشود. این مورفولوژی به عنوان مشخصه پوشش تانتالم ۵ شناخته میشود [۴۱]. همچنین در این تصویر مشاهده میشود که سطح پوشش پیوسته و عاری از ترک و سایر عیوب است. این ویژگی می تواند در رفتار خوردگی پوشش اثر مثبت داشته باشد. بررسی مورفولوژی سطح پوشش تانتالم با AFM نشان داد که و مجذور مربعات زبری (Rrms)^{۲۰} حدود ۹/۶ نانومتر از خود نشان میدهد (شکل (۲-ب و -ج)). همچنین شکل (۲-د) نشان میدهد که تغییرات ارتفاع زبری در پوشش، توزیعی نرمال با بیشینه حدود ۱۳۰ نانومتر دارد که این امر نشاندهنده یکنواختی سطح پوشش پوشش به خوبی پدیدار است. در این ارتباط فاصله بین سوزنی پوشش به خوبی پدیدار است. در این ارتباط فاصله بین سوزنی



شکل (۲): تصویر: (الف): FESEM، (ب)" AFM دوبعدی، (ج): AFM سهبعدی از سطح پوشش تانتالم به همراه و (د): منحنی توزیع ارتفاع زبری

۳-۲- بررسی رفتار خوردگی پوشش تانتالم ۳-۲-۱- آزمون PDP شکل (۳) منحنی PDP فولاد زنگنزن ۳۱۶L بدون پوشش را درمقایسه با پوشش تانتالم را نشان میدهد.



سکل (۱): متحتی های ۲DT فولا د ۱۶۲۲ بدون پوسش و با پوسش نانتالم

مشاهده می شود که در محیط مورد مطالعه هر دونمونه به سرعت رویین شده و رفتار رویینگی بدون منطقه انتقالی فعال–رویین دارد.

این انتقال خطی و سریع از حالت فعال به رویین در اثر افزایش پتانسیل بیان گر پایداری شیمیایی نمونه ها است [۴۲]. همچنین مشاهده می شود که منحنی PDP نمونه لایه نشانی شده به سمت پتانسیل های نجیب تر و چگالی جریان های کمتر جابجا شده است که به ترتیب بیان گر خنثی بودن بیشتر پوشش نسبت به زیر لایه و مقاومت خورد گی بهتر پوشش از زیر لایه است. به منظور بررسی دقیق تر، با استفاده از منحنی های PDP پارامتر های الکترو شیمیایی نظیر پتانسیل خورد گی (Ecorr) و چگالی جریان خورد گی (آcorr)، نظیر پتانسیل خورد گی (آ [۴۴] محاسبه و در جدول (۱) از طریق روش برونیابی تافل^{۱۲} [۳۴] محاسبه و در جدول (۱) مقاله ای دیگر [۴۴] شرح داده شده است، به ترتیب مقاومت پلاریز اسیون (R_p) و بازده حفاظت (۲) محاسبه و در جدول (۱)

جدول (۱) نشان میدهد که پتانسیل خوردگی ۸۴ میلی ولت SCE برای پوشش تانتالم به مراتب نجیب تر از پتانسیل خوردگی زیرلایه فولاد زنگنزن ۳۱۶L (۷۰- میلی ولت SCE) است. بنابراین پوشش تانتالم از لحاظ تر مودینامیکی استعداد به خوردگی کمتری نسبت به زیرلایه دارد و به صورت کاتدی از زیرلایه محافظت خوردگی زیرلایه را بشدت افزایش میدهد و سبب کاهش چگالی جریان خوردگی از ۱۹۱/۰ به ۱۹۰/۰ میکروآمپر بر سانتی متر مربع و همچنین افزایش مقاومت پلاریزاسیون از ۲۸۱ به حدود ۶۸۵ کیلواهم بر سانتی متر مربع می شود و بازده حفاظت حدود ۷۰ درصد را به همراه می آورد. مقاومت بالای پلاریزاسیون پوشش تانتالم به لایه رویین اکسید تانتالم که روی سطح آن وجود دارد، نسبت داده می شود. این لایه رویین بدون عیب بوده و به علت ضخامت بسیار کم، تنش پسماند ناچیزی دارد. همچنین این لایه پیوندی قوی با فلز تانتالم داشته و در صورت آسیب دیدن به طور خود به خود ترمیم می شود. می کند. در این شرایط، در زوج گالوانیک پوشش-زیرلایه که در محل حفرات راهباز و یا در صورت آسیب دیدن و جداشدن موضعی پوشش تشکیل میشود، پوشش تانتالم نقش کاتد و زیرلایه نقش آند را بازی می کند. زیرلایه در پوششهای کاتدی بشدت نسبت به وجود حفرات راهباز و آسیب دیدگی موضعی پوشش آسیبپذیر است، زیرا در این حفرات سطح کمی از زیرلایه (آند) باید الکترون مورد نیاز برای واکنش کاتدی بر روی سطح وسیع پوشش مجاور (کاتد) را تامین کند، که این امر خوردگی شدید زیرلایه را به همراه دارد.

با بررسی جدول (۱) مشاهده می شود که پوشش تانتالم مقاومت

جدول (۱): پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از منحنیهای PDP فولاد زنگنزن ۳۱۶L بدون پوشش و لایهنشانی شده با پوشش تانتالم

Р	Pi	R _p	βc	β_a	i _{corr}	Ecorr	
(%)	(%)	$(k\Omega.cm^{-2})$	(mV)	(mV)	(µA.cm ⁻²)	(mV)	
-	_	191	211	198	•/141	_ V •	819 L
۶/۱۷	٧٠/٢١	۶۸۵/۶	197	7.9	•/•۴٢	٨۴	پوشش تانتالم

بنابراین این لایه رویین می تواند مقاومت خوردگی بالای فلز تانتالم در محیط های خورنده را فراهم آورد [۲۴]. وجود این لایه رویین سبب می شود تا پوشش تانتالم به صورت یک سد فیزیکی عمل کرده و به طور موثری از نفوذ محلول خورنده به زیرلایه جلوگیری کند. با این وجود هر گز امکان حفاظت صددرصدی برای پوشش ها وجود نداشته و همواره مقداری از محلول خورنده از طریق عیوب موجود در پوشش به زیرلایه نفوذ پیدا می کند. در ND هستند که محلول خورنده می تواند از طریق آنها به زیرلایه دسترسی پیدا کند [۳۹]. بنابراین چگالی حفرات راهباز، تعیین کننده مقاومت خوردگی پوشش تانتالم است. در این ارتباط شاخص تخلخل^{۲۲} (۹)، که با چگالی حفرات راهباز موجود در پوشش نسبت مستقیم دارد را می توان به روش الکتروشیمیایی و توسط رابطه (۲) محاسبه کرد [۴۵].

$$P = \left(\frac{R_{p}^{s}}{R_{p}^{c}}\right) \times 10^{\left(-\left|\frac{\Delta E_{corr}}{\beta_{a}^{s}}\right|\right)}$$
(Y)

در این رابطه P شاخص تخلخل، R_p^s مقاومت پلاریزاسیون زیرلایه، R_p^c مقاومت پلاریزاسیون پوشش، ΔE_{corr} اختلاف پتانسیل خوردگی و β_a^s شیب تافل آندی زیرلایه هستند. همان طور که در جدول (۱) آورده شده، شاخص تخلخل برای پوشش تانتالم مورد مطالعه حدود ۶ درصد محاسبه شده است.

EIS آزمون EIS

پیش تر اشاره شد که خوردگی فولاد زنگنزن ۲۱۶۱ لایهنشانی شده با پوشش تانتالم از طریق نفوذ محلول خورنده به حفرات راهباز موجود در پوشش و خوردگی زیرلایه در این مناطق، صورت می پذیرد. برای تایید صحت این مکانیزم و همچنین درک بیشتر از رفتار و مکانیزم خوردگی فولاد زنگنزن ۲۱۶۲ و پوشش تانتالم در محیط مورد مطالعه، از آزمون EIS کمک گرفته شد. شکل (۴) رسم نایکوییست^{۲۲} و رسم بُد^{۲۲} حاصل از آزمون EIS برای زیرلایه و پوشش تانتالم را نشان می دهد. فرکانس پایین($au_1 R_{
m c} = C_{
m d} R_{
m c}$) به مقاومت انتقال بار و ظرفیت خازنی لایه دو گانه الکتریکی نسبت داده می شود [۴۹]. در این مطالعات به علت وجود انحراف از رفتار خازنی ایده آل در سیستم، از یک عنصر فازی ثابت (CPE)^{۲۵} به جای خازن استفاده می شود. امپدانس CPE توسط رابطه (۳) بیان می شود.

$$Z_{CPE} = \frac{1}{Y_0(j\omega)^n}$$
(٣)

در این رابطه Y₀ و n اعداد ثابت هستند، 1- $\sqrt{j} = j e^{(0)} e^{(0)}$ زاویهای است. به طور رایج پوشش های PVD مستعد به خوردگی حفرهای در حفرات راهباز هستند. نفوذ محلول خورنده به درون پوشش معمولاً با استفاده از اجزای وابسته به نفوذ در مدار معادل توصیف می شود که این اجزا فرآیند نفوذ تحت شرایط مرزی خاص را توصیف می کنند [۴۸]. لیو^{۹۶} و همکاران [۴۸، ۵۱] گزارش دادهاند که برای آنالیز طیف EIS پوشش های PVD، بسته به خواص الکتروشیمیایی زیرلایه، ریزساختار پوشش و همچنین اندازه و شکل عیوب ساختاری موجود در پوشش، مدارهای معادل مختلفی به کار برده می شوند. شکل (۵-ب) مدار معادل استفاده شده در این پژوهش جهت آنالیز طیف امپدانس پوشش مختلفی به کار برده می شوند. شکل (۵-ب) مدار معادل استفاده شده در این پژوهش جهت آنالیز طیف امپدانس پوشش مغاومت محلول و عنصر وابسته به نفوذ در حفرات راهباز هستند.



شکل (۵): مدار معادل مورد استفاده برای آنالیز دادههای EIS مربوط به فولاد زنگینزن ۳۱۶L: (الف): بدون پوشش و (ب): با پوشش تانتالم



در رسم نایکوییست (شکل (۴-الف)) مشاهده می شود که امپدانس حقیقی نمونه لایهنشانی شده با پوشش تانتالم بیشتر از فولاد زنگنزن ۳۱۶L است و در نتیجه مشابه با نتایج آزمون PDP، می توان بیان داشت که پوشش تانتالم مقاومت خوردگی فولاد ۳۱۶L را افزایش داده است. افزون بر این، زاویه بیشینه فاز در رسم بُد در هر دو نمونه (شکل (۴–ب)) نزدیک به $\frac{\pi}{2}$ است که بیان گر رفتار خازنی فولاد زنگنزن ۳۱۶L و پوشش تانتالم است [۲۸، ۳۰، ۴۸]. به منظور بررسی دقیق تر رفتار الکتروشیمیایی زیرلایه و پوشش، از دو مدار معادل موجود در شکل (۵)، جهت شبیه سازی فصل مشتر ک محلول/نمونه و آنالیز منحنی های EIS استفاده شد. شکل (۵–الف) متداول ترین مدار معادل برای آنالیز خوردگی موضعی فولادهای زنگنزن است [۵۰-۴۹]. در این مدار $r_1 = C_{_{\mathrm{B}}}R_{_{\mathrm{B}}}$ مدار $r_1 = C_{_{\mathrm{B}}}R_{_{\mathrm{B}}}$ مدار R_{s} مدار مقاومت محلول است و ثابت زمانی منطقه فرکانس بالا در طیف امیدانس فولاد ۳۱۶L، به مقاومت محلول در حفرات لايه رويين و ظرفيت خارني منطقه بدون عيب لايه رويين نسبت داده مىشود. ثابت زمانى همبسته با منطقه

در این رابطه Cp ظرفیت خازنی لایه رویین فولاد زنگنزن ۳۱۶L،

Cf ظرفیت خازنی لایه رویین پوشش تانتالم و f کسر سطحی

دادههای EIS بدست آمده با استفاده از مدارهای معادل معرفی شده

در شکل (۴) توسط نرمافزار Zview/Zplot [۵۲] برازش شدند. منحنیهای برازش برای زیرلایه و پوشش در شکل (۴) به صورت

خط رسم شده و نتایج حاصل از برازش در جدول (۲) آورده شده

است. این جدول در تطابق با نتایج آزمون PDP نشان میدهد که استفاده از پوشش تانتالم سبب افزایش چشم گیر مقاومت

خوردگی فولاد زنگنزن ۳۱۶L شده است. همچنین با توجه به

اینکه Ct برای نمونه لایهنشانی شده از Cp زیرلایه بیشتر است، بر

طبق رابطه (۴) می توان بیان داشت که Ct با f متناسب است. این

نتیجه از آنجا حائز اهمیت است که نشان میدهد پوشش با C_t

کوچک تر چگالی حفرات راهباز کمتری دارد. بنابراین از C

می توان به عنوان معیاری برای ارزیابی میزان این نوع عیوب در پوشش استفاده کرد. افزون بر این، عموماً انحراف پارامتر توانی

n_d و n_t از مقدار واحد را به زبری زیاد، وجود غیریکنواختی و

بافت در سطح نسبت مي دهند [۵۱، ۵۳]. در نتيجه با توجه به جدول

(۲) مشاهده می شود که مقدار این پارامترها نزدیک به یک است

و مي توان بيان داشت كه هر دونمونه سطحي يكنواخت دارند.

حفرات راهباز موجود در پوشش هستند ($\mathbf{f} \leq \mathbf{f} \geq \mathbf{0}$).

عنصر W_{po} ماهیت فیزیکی مشابه با CPE دارد و امیدانس آن توسط رابطه (۳) توصيف مي شود. اين عنصر، نفوذ نيمه محدود و خوردگی موضعی را توصیف کرده، و توسط وجود یک خط انتقالی در منطقه فرکانس پایین در رسم نایکوییست طیف EIS شناخته می شود [۴۹]. همان طور که در شکل (۳) نشان داده شد، فولاد زنگنزن ۳۱۶L در محلول اسید سولفوریک رقیق رفتار رويين از خود نشان داده و در نتيجه بلافاصله پس از تماس اين فولاد با محلول مورد مطالعه یک لایه رویین نازک با ثابت دىالكتريك بالا، روى سطح آن تشكيل مىشود. اين لايه رويين همچنین می تواند روی سطح فولاد زنگنزن ۳۱۶L لایهنشانی شده با پوشش تانتالم، در محل حفرات راهباز تشکیل شده و علاوه بر محافظت از سطح زیرلایه بدون پوشش در این مناطق، رفتار خازنی از خود نشان دهد (شکل (۵–ب)) [۴۸]. به سختی می توان خواص دىالكتريك لايه رويين تشكيل شده روى زيرلايه (احتمالاًاکسید کروم) در نقاط بدون پوشش را از لایه رویین تشکیل شده روی پوشش تانتالم (Ta2O5) در نقاط بدون عیب پوشش تشخیص داد. بنابراین در مدار معادل مطابق با رابطه (۴) از عنصر C_t به جای این دو خازن استفاده میگردد.

$$C_t = f. C_p + (1-f). C_f$$
 (F)

χ^2	R _{ct}	n _{dl}	W_{po} يا C_{dl}	R_{po} یا R_p	n _p	C_t يا C_p	Rs	
	$(k\Omega.cm^2)$	يا n _{po}	$(\mu F.s^{n-1}.cm^{-2})$	$(k\Omega.cm^2)$	يا n _t	$(\mu F.s^{n-1}.cm^{-2})$	$(\Omega.cm^2)$	
۳/۴× ^{۴–} ۱۰	۵۰/۷	۰/۸۱	420/0	9 V/Y	•/9٣	94/4	۲	#19L
۴/۴× ^{۴–} ۱۰	-	• /۵	۳۳/۴	444/1	•/91	۱۳/۸	۴/۵	پوشش تانتالم

جدول (۲): پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از آزمون EIS برای فولاد زنگنزن ۳۱۶L بدون پوشش و لایهنشانی شده با پوشش تانتالم

۴- نتیجه گیری

پوشش های تانتالم به روش کندوپاش مگنترونی روی زیرلایه های سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگنزن ۳۱۶L لایه نشانی شد. براساس یافته های ارائه شده در این پژوهش، نتایج به شرح زیر هستند: ۱- استفاده از لایه آستری نیترید تانتالم سبب تغییر ساختار کریستالی پوشش تانتالم از مخلوط فازی β + α به فاز α می شود.

۲ - فشار پایین لایهنشانی مورد استفاده در این پژوهش، سبب رشد
 ۱/۴ ساختاری ستونی و فشرده و ایجاد تنش پسماند فشاری حدود ۱/۴
 گیگاپاسکال در پوشش تانتالم شد.

۳- لایهنشانی پوشش تانتالم روی فولاد زنگنزن ۳۱۶L، بازده حفاظت خوردگی بیشتر از ۷۰ درصد را سبب می شود. این مقاومت بالای خوردگی به علت تشکیل لایه رویین Ta₂O5 روی simulation", Applied Surface Science, Vol. 367, pp. 197-204, 2016.

- [7] R. Gago, M. Vinnichenko, R. Hübner & A. Redondo Cubero, "Bonding structure and morphology of chromium oxide films grown by pulsed-DC reactive magnetron sputter deposition", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 672, pp. 529-535, 2016.
- [8] H. Gao, Y. Li, C. Li, F. Ma, Z. Song & K. Xu, "Tuning the electronic properties in TaNx/Ag nanocomposite thin films", RSC Advances, Vol. 6, pp. 30998-31004, 2016.
- [9] N. Srinatha, Y. S. No, V. B. Kamble, S. Chakravarty, N. Suriyamurthy, B. Angadi, A. M. Umarji & W. K. Choi, "Effect of RF power on the structural, optical and gas sensing properties of RFsputtered Al doped ZnO thin films", RSC Advances, Vol. 6, pp. 9779-9788, 2016.
- [10] D. Zheng, J. Xiong, P. Guo, S. Wang & H. Gu, "AlN-based film buck acoustic resonator operated in shear mode for detection of carcinoembryonic antigens", RSC Advances, Vol. 6, pp. 4908-4913, 2016.

[۱۱] م. یاری، م. مجتهدزاده و ع. افشار، "تأثیر زمان لایه نشانی بر خواص ساختاری و فیزیکی پوشش های کربنی لایه نشانی شده با روش کندوپاش مگنترونی"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۵. شماره ۲، ص. ۱۰–۱، ۱۳۹۰.

- [12] A. I. H. Committee, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special- Purpose Materials, ASM International, 1990.
- [13] S. Myers, J. Lin, R.M. Souza, W. D. Sproul & J. J. Moore, "The β to α phase transition of tantalum coatings deposited by modulated pulsed power magnetron sputtering", Surface and Coatings Technology, Vol. 214, pp. 38-45, 2013.
- [14] A. A. Al-masha'al, A. Bunting & R. Cheung, "Evaluation of residual stress in sputtered tantalum thin-film", Applied Surface Science, Vol. 371, pp. 571-575, 2016.
- [15] M. Alishahi, F. Mahboubi, S. M. Mousavi Khoie, M. Aparicio, R. Hübner, F. Soldera & R. Gago,

سطح پوشش است. این لایه به شدت در برابر اسید سولفوریک رقیق مقاوم است. ۴- آزمون EIS نشان داد که مکانیزم خوردگی پوشش تانتالم تحت کنترل نفوذ محلول خورنده از طریق حفرات راهباز موجود در پوشش به زیرلایه است، که می توان آن را توسط عنصر نفوذ نیمه محدود شبیه سازی کرد.

۵- تشکر و قدردانی

نویسندگان بابت حمایتهای صورت گرفته در راستای انجام این پژوهش، از رائول گاگو (موسسه علم مواد مادرید-اسپانیا)، ماریو اپاراسیو (موسسه سرامیک و شیشه-اسپانیا) و رنه هابنر (موسسه فیزیک پرتو یونی و تحقیقات مواد-آلمان) تشکر میکنند. **۶- مراجع**

- م. علیشاهی، م. ح. بینا و س. م. منیرواقفی، "شکیل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس کامپوزیتی نیکل-فسفر-نانولوله کربنی"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۷، شماره ۳، ص. ۳۸-۳۱، ۱۳۹۲.
- [۲] ر. سلیمانی گیلاکجانی، ف. محبوبی و م. علیشاهی، "ررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش الکترولس نانوکامپوزیتی-Ni-P siCاعمال شده روی سطح آلومینیم "، دوره ۸، شماره ۲، ص. ۱۲۱– ۱۳۹۰. ۱۳۹۲.
- [3] D. E. J. Talbot & J. D. R. Talbot, Corrosion Science and Technology, Second Edition, CRC Press, 2007.
- [4] P. J. Kelly & R. D. Arnell, "Magnetron sputtering: a review of recent developments and applications", Vacuum, Vol. 56, pp. 159-172, 2000.
- [5] C. Petrogalli, L. Montesano, M. Gelfi, G. M. La Vecchia & L. Solazzi, "Tribological and corrosion behavior of CrN coatings: Roles of substrate and deposition defects", Surface and Coatings Technology, Vol. 258, pp. 878-885, 2014.
- [6] S. S. Firouzabadi, K. Dehghani, M. Naderi & F. Mahboubi, "Numerical investigation of sputtering power effect on nano-tribological properties of tantalum-nitride film using molecular dynamics

chemical processing industry–A critical survey", Materials and Corrosion, Vol. 46, pp. 689-700, 1995.

- [25] P. E. Philip & A. Schweitzer, "Fundamentals of Metallic Corrosion: Atmospheric and Media Corrosion of Metals", CRC Press, 2006.
- [26]S. D. Cramer, B. S. Covino & C. Moosbrugger, ASM Handbook Volume 13b: Corrosion: Materials, ASM International, 2005.
- [27] A. Robin & J. L. Rosa, "Corrosion behavior of niobium, tantalum and their alloys in hot hydrochloric and phosphoric acid solutions", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 18, pp. 13-21, 2000.
- [28] S. Maeng, L. Axe, T. A. Tyson, L. Gladczuk & M. Sosnowski, "Corrosion behaviour of magnetron sputtered α and β -Ta coatings on AISI 4340 steel as a function of coating thickness", Corrosion Science, Vol. 48, pp. 2154-2171, 2006.
- [29] S. M. Maeng, L. Axe, T. A. Tyson, L. Gladczuk & M. Sosnowski, "Corrosion behavior of magnetron sputtered α-Ta coatings on smooth and rough steel substrates", Surface and Coatings Technology, Vol. 200, pp. 5717-5724, 2006.
- [30] A. Robin, "Corrosion behaviour of tantalum in sodium hydroxide solutions", Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 33, pp. 37-42, 2003.
- [31] M. Ikeda, M. Murooka & K. Suzuki, "Semiepitaxial bcc Ta growth on metal nitride", Japanese journal of applied physics, Vol. 41, pp. 3902, 2002.
- [32]B. Cullity, "Elements of X-ray Diffraction, 2nd", Adisson-Wesley Publishing. USA, 1978.
- [33]G. C. A. M. Janssen, M. M. Abdalla, F. Van Keulen, B. R. Pujada & B. Van Venrooy, "Celebrating the 100th anniversary of the Stoney equation for film stress: Developments from polycrystalline steel strips to single crystal silicon wafers", Thin Solid Films, Vol. 517, pp. 1858-1867, 2009.
- [34]G. G. Stoney, "The Tension of Metallic Films Deposited by Electrolysis", Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical

"Electrochemical behavior of nanocrystalline Ta/TaN multilayer on 316L stainless steel: Novel bipolar plates for proton exchange membrane fuelcells", Journal of Power Sources, Vol. 322, pp. 1-9, 2016.

- [16] L. Gladczuk, A. Patel, C. Singh Paur & M. Sosnowski, "Tantalum films for protective coatings of steel", Thin Solid Films, Vol. 467, pp. 150-157, 2004.
- [17] K. Tillmann, A. Thust, A. Gerber, M. P. Weides & K. Urban, "Atomic structure of Beta-tantalum nanocrystallites", Microsc Microanal, Vol. 11, pp. 534-544, 2005.
- [18]E. Mastropaolo, R. Latif, E. Grady & R. Cheung, "Control of stress in tantalum thin films for the fabrication of 3D MEMS structures", Journal of Vacuum Science & Technology B, Vol. 31, pp. 06FD02, 2013.
- [19]S. W. Myers, "Investigation of the beta to alpha phase transition of thick tantalum coatings deposited by modulated pulsed power magnetron sputtering", thesis, Ann Arbor, United States, 2012.
- [20] D. W. Matson, E. D. McClanahan, S. L. Lee & D. Windover, "Properties of thick sputtered Ta used for protective gun tube coatings", Surface and Coatings Technology, Vol. 146, pp. 344-350, 2001.
- [21]H. Yu, L. Yang, L. Zhu, X. Jian, Z. Wang & L. Jiang, "Anticorrosion properties of Ta-coated 316L stainless steel as bipolar plate material in proton exchange membrane fuel cells", Journal of Power Sources, Vol. 191, pp. 495-500, 2009.
- [22] V. H. Pham, S. H. Lee, Y. Li, H. E. Kim, K. H. Shin & Y. H. Koh, "Utility of tantalum (Ta) coating to improve surface hardness in vitro bioactivity and biocompatibility of Co–Cr", Thin Solid Films, Vol. 536, pp. 269-274, 2013.
- [23] M. Roy, V. K. Balla, S. Bose & A. Bandyopadhyay, "Comparison of Tantalum and Hydroxyapatite Coatings on Titanium for Applications in Load Bearing Implants", Advanced Engineering Materials, Vol. 12, pp. B637-B641, 2010.
- [24] U. Gramberg, M. Renner & H. Diekmann, "Tantalum as a material of construction for the

"Effect of nitrides on the corrosion behaviour of 316L SS bipolar plates for Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, pp. 3359-3369, 2015.

- [45] J. Creus, H. Mazille & H. Idrissi, "Porosity evaluation of protective coatings onto steel, through electrochemical techniques", Surface and Coatings Technology, Vol. 130, pp. 224-232, 2000.
- [46] I. M. Notter & D. R. Gabe, "Polarisation resistance methods for measurement of the porosity of thin metal coatings", Corrosion Science, Vol. 34, pp. 851-870, 1993.
- [47] F. C. Walsh, C. Ponce de León, C. Kerr, S. Court & B. D. Barker, "Electrochemical characterisation of the porosity and corrosion resistance of electrochemically deposited metal coatings", Surface and Coatings Technology, Vol. 202, pp. 5092-5102, 2008.
- [48] C. Liu, Q. Bi, A. Leyland & A. Matthews, "An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part I. Establishment of equivalent circuits for EIS data modelling", Corrosion Science, Vol. 45, pp. 1243-1256, 2003.
- [49]J. C. Galván, M. T. Larrea, I. Braceras, M. Multigner & J. L. González-Carrasco, "In vitro corrosion behaviour of surgical 316LVM stainless steel modified by Si+ ion implantation – An electrochemical impedance spectroscopy study", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 676, pp. 414-427, 2016.
- [50] J. Flis & A. Gajek, "Impedance parameters of nitrided 304L stainless steel in an acidified sulphate solution", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 515, pp. 82-90, 2001.
- [51]C. Liu, Q. Bi, A. Leyland & A. Matthews, "An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part II.: EIS interpretation of corrosion behaviour", Corrosion Science, Vol. 45, pp. 1257-1273, 2003.
- [52] ZPlot[®]/ZView[™](version 3.3f), A software for EIS measurements and data analysis written by D.

and Engineering Sciences, Vol. 82, pp. 172-175, 1909.

- [35] F. M. d'Heurle, "Aluminum films deposited by rf sputtering", Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 1, pp. 725-732, 1970.
- [36]G. Abadias, L. E. Koutsokeras, P. Guerin & P. Patsalas, "Stress evolution in magnetron sputtered Ti–Zr–N and Ti–Ta–N films studied by in situ wafer curvature: Role of energetic particles", Thin Solid Films, Vol. 518, pp. 1532-1537, 2009.
- [37] H. Windischmann, "Intrinsic stress in sputterdeposited thin films", Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, Vol. 17, pp. 547-596, 1992.
- [38]G. Abadias, W. P. Leroy, S. Mahieu & D. Depla, "Influence of particle and energy flux on stress and texture development in magnetron sputtered TiN films", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 46, pp. 055301, 2013.
- [39] D. M. Mattox, Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing film formation, adhesion, surface preparation and contamination control, Noyes Publications, Westwood, N. J., 1998.
- [40] Y. G. Shen, Y. W. Mai, D. R. McKenzie, Q. C. Zhang, W. D. McFall & W. E. McBride, "Composition, residual stress, and structural properties of thin tungsten nitride films deposited by reactive magnetron sputtering", Journal of Applied Physics, Vol. 88, pp. 1380, 2000.
- [41] A. A. Navid & A. M. Hodge, "Controllable residual stresses in sputtered nanostructured alphatantalum", Scripta Materialia, Vol. 63, pp. 867-870, 2010.
- [42] H. Koivuluoto, J. Näkki & P. Vuoristo, "Corrosion properties of cold-sprayed tantalum coatings", Journal of Thermal Spray Technology, Vol. 18, pp. 75-82, 2009.
- [43]E. McCafferty, "Validation of corrosion rates measured by the Tafel extrapolation method", Corrosion Science, Vol. 47, pp. 3202-3215, 2005.
- [44] S. Pugal Mani, A. Srinivasan & N. Rajendran,

Johnson, Scribner Associates Inc, Southern Pines, NC (USA), Copyright© 1990-2013 (http://www.scribner.com)).

[53] M. Alishahi, S. M. Monirvaghefi, A. Saatchi & S. M. Hosseini, "The effect of carbon nanotubes on the corrosion and tribological behavior of electroless Ni–P–CNT composite coating", Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 2439-2446, 2012.

۷- پینوشت

- [1] Magnetron sputtering deposition
- [2] Physical vapor deposition
- [3] Tantalum pentoxide
- [4] Field-emission scanning electron microscopy
- [5] Transmission electron microscopy
- [6] Atomic force microscopy
- [7] X-ray diffraction
- [8] Potentiodynamic polarization
- [9] Electrochemical Impedance Spectroscopy
- [10] Grounded substrate
- [11] Standard cubic centimeters per minute
- [12] Transmission electron microscopy
- [13] Four-point probe
- [14] Standard calomel electrode
- [15]Ikeda
- [16]Pseudo-epitaxially
- [17] Scherrer
- [18] Stoney equation
- [19] Atomic peening mechanism
- [20] Root mean square roughness
- [21] Tafel extrapolation method
- [22]Porosity index
- [23]Nyquist
- [24]Bode
- [25] Constant phase element
- [26]Liu

Corrosion behavior of magnetron sputtered tantalum coating

Mostafa Alishahi*¹, Farzad Mahboubi², Seyed Mahmoud Mousavi Khoie³

1- Assistant Professor, Faculty of Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2- Associate professor, Amirkabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Tehran, Iran

3- Professor, Amirkabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Tehran, Iran

*Corresponding author: m.alishahi@hsu.ac.ir

Abstract

In this study, tantalum (Ta) thin film was deposited on Si (100) and 316L stainless steel (SS) substrates by DC magnetron sputtering. The structural properties of Ta film were investigated by X-ray diffraction analysis. In addition, the scanning and transmission electron microscopies as well as atomic force microscopy were used to study the cross-section and the morphology of the coating. The corrosion behavior of the bare and Ta-coated 316L SS was evaluated by potentiodynamic polarization test. The electrochemical impedance spectroscopy was employed to study the corrosion mechanisms. The results revealed that the structure of Ta coating on either Si and SS substrates is a mixture of $\alpha+\beta$ phases, while pre-deposition of a thin tantalum nitride seed layer causes to the deposition of pure α -Ta and decreases the sheet resistance from 90 $\mu\Omega$.cm to 15 $\mu\Omega$.cm. Microscopic evaluations show that the Ta coating is compact, homogeneous and defect-free, exhibiting a columnar structure with a surface roughness of less than 6 nm. Furthermore, the corrosion studies show that the Ta coating act as a physical barrier between corrosive electrolyte and substrate and, in this way, provide a protective efficiency of more than 70%. In this regard, the diffusion of corrosive electrolyte toward the substrates through open porosities was found to be the corrosion mechanism of the Ta coating and the porosity index of the coating was calculated to be about 6%.

Keywords:

Tantalum Coating, Magnetron Sputtering, Corrosion, Polarization, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Open Porosities.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Mostafa Alishahi, Farzad Mahboubi, Seyed Mahmoud Mousavi Khoie, Corrosion behavior of magnetron sputtered tantalum coating, in Persian, New Process in Material Engineering, 2018, 12(2), 139-151.